

**國立中山大學半導體及重點科技研究學院  
研究生學位考試準備期間公假申請表**

學生姓名			學號			
系 所	<input type="checkbox"/> 先進半導體封測研究所		<input type="checkbox"/> 精密電子零組件研究所			
實習公司						
學位口試 日期	民國 年 月 日 (星期 )					
請假日期 (年/月/日)	<hr style="border: 0.5px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <span style="float: right;">(共_____天)</span> 註 1. 以處理學位考試及辦理離校手續相關事宜為限。					
簽核流程 (請簽章)	實習單位主管	年 月 日				
	指導教授	年 月 日				
	共同指導教授	年 月 日				
	系所主管	年 月 日				
說 明	1. 考量學生在畢業該學期末(已完成企業實習課程及評分)至畢業前，應有足夠時間讓學生專心準備畢業論文/專題技術報告撰寫、學位考試、依口試委員意見修改畢業論文/專題技術報告以及辦理離校手續等事務，以順利進入培育企業服務為宗旨，學生於舉行學位口試前後各 2 週期間(但不可超過該學期結束日)得依實際情況提出需求，並經實習單位主管、指導教授與共同指導教授及實習公司同意申請公假日期後，可不進公司實習且將準備學位考試及辦理離校手續納入企業實習獎助金核發的範疇。惟學生不得利用前揭舉行學位口試前後各 2 週之時間進行與上述目的無關之情事，違者經查獲將取消其企業實習獎助金核發資格，以符合校外實習合約書精神。					
	2. 本表經指導教授、共同指導教授及系所主管簽章後，請繳交至院辦存查，另學生向實習公司申請公假時，需檢附已簽核之公假申請表副本，經實習公司行政程序同意後，始完成公假手續。					

院辦收訖 (簽章/日期) :